

中信证券股份有限公司
关于厦门优迅芯片股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之
上市保荐书

保荐人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年十月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”、“保荐人”或“中信证券”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书相关用语具有与《厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（上会稿）》中相同的含义。

目 录

声 明.....	1
目 录.....	2
一、发行人概况	3
二、申请上市股票的发行情况	12
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况.....	13
四、保荐人是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明.....	14
五、保荐人承诺事项	15
六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序	16
七、保荐人关于发行人符合科创板定位要求的核查意见.....	16
八、保荐人对发行人是否符合科创板上市条件的说明	18
九、保荐人对发行人持续督导工作的安排	18
十、保荐人认为应当说明的其他事项	19
十一、保荐人对本次股票上市的推荐结论	19

一、发行人概况

（一）发行人基本资料

中文名称：	厦门优迅芯片股份有限公司
英文名称：	XIAMEN UX IC CO., LTD.
注册资本：	6,000.00 万元人民币
法定代表人：	柯炳彝
成立时间：	2003 年 2 月 10 日
整体变更日期：	2024 年 5 月 8 日
公司住所：	厦门市软件园观日路 52 号 402
公司办公地址：	厦门市软件园观日路 52 号 402
邮政编码：	361008
电话号码：	0592-2518169
传真号码：	0592-2518169
互联网网址：	www.uxfastic.com
电子信箱：	ir@uxfastic.com
负责信息披露和投资者关系的部门：	董事会办公室
信息披露负责人：	杨霞
信息披露负责人电话：	0592-2518169

（二）主营业务情况

优迅股份作为国内光通信领域的“国家级制造业单项冠军企业”，专注于光通信前端收发电芯片的研发、设计与销售。光通信电芯片是光通信光电协同系统的“神经中枢”。作为光模组的关键元器件，光通信电芯片承担着对光通信电信号进行放大、驱动、重定时以及处理复杂数字信号的重要任务，其性能直接影响整个光通信系统的性能和可靠性。公司产品广泛应用于光模组（包括光收发组件、光模块和光终端）中，应用场景涵盖接入网、4G/5G/5G-A 无线网络、数据中心、城域网和骨干网等领域。

自成立以来，优迅股份在光通信电芯片设计领域形成了完备的核心技术体系，在收发合一、高速调制、光电协同等关键领域实现国产化技术突破。公司坚持正向设计，具备深亚微米 CMOS、锗硅 Bi-CMOS 双工艺设计和集成研发能力，掌握全套带宽拓展、阻抗匹配、信号完整性补偿等技术，目前已实现 155Mbps～

100Gbps 速率光通信电芯片产品的批量出货，并正在积极研发 50G PON 收发芯片、400Gbps 及 800Gbps 数据中心收发芯片、4 通道 128Gbaud 相干收发芯片、FMCW 激光雷达前端电芯片、车载光通信电芯片等系列新产品。

公司注重客户需求，形成完整、高集成、低功耗、易于客户生产的差异化产品解决方案，下游涵盖国内外主流运营商、系统设备商、光模块/组件厂商。基于产品持续的创新、优越的性能、稳定的质量表现，优迅股份已成为国内光通信电芯片细分领域的领军企业。

公司以创新为驱动，独立或牵头承担了包括科技部“863 计划”、科技部“国家国际科技合作专项项目”、工信部“工业强基项目”、科技部“国家科技重点研发计划项目”在内的多个重大国家级科研攻关项目，并参与制定 22 项国家及行业标准。凭借卓越的技术创新能力，公司获得了国家及行业的高度认可，先后获评“国家规划布局内集成电路设计企业”“国家知识产权优势企业”“国家级专精特新重点‘小巨人’企业”及“国家级制造业单项冠军企业”等国家级资质。公司产品亦屡获殊荣，六次荣膺“中国芯”奖项，多次获评“中国半导体创新产品和技术”，彰显了领先的技术实力与市场竞争力。通过“量产一代、研发一代、储备一代”的前瞻策略，优迅股份正从国产替代的追赶者，成长为全球光通信电芯片技术标准的定义者与引领者，推动中国光通信电芯片在全球产业链中实现从“跟跑”到“领跑”的战略升级。

（三）核心技术情况

经过多年的研发与产业化积累，公司在主营业务领域已拥有深厚的技术储备，成功构建起“高速率高性能信号处理技术群”“突发模式信号处理技术群”“数模混合及智能控制处理技术群”“高速率芯片测试技术群”“光传感线性低噪模拟收发芯片设计技术群”“SOC 关键 IP 及 ASIC 集成技术群”“硅光组件技术群”7 大核心技术集群以及对应的 21 项核心技术。

公司的核心技术系在实际产品设计中积累形成，已实现产业化。报告期内，公司应用核心技术的产品营业收入金额占主营业务收入的占比均为 100.00%。

公司与主营业务相关的核心技术基本情况如下：

核心技术群	核心技术	技术来源	技术所处阶段	对应产品类型
高速率高性能信号处理技术群	高带宽、低噪声、宽动态跨阻放大器设计技术	自研	成熟应用	高速率跨阻放大器芯片
	高带宽、高增益限幅放大器设计技术	自研	成熟应用	高速率限幅放大器芯片
	高带宽、高驱动能力激光驱动器设计技术	自研	成熟应用	高速率激光驱动器芯片
	高速率、低抖动、高精度时钟数据恢复技术	自研	成熟应用	高速率集成时钟数据恢复器芯片
	高带宽、高线性信号处理技术	自研	样品	高速率线性激光驱动芯片、高速率线性跨阻放大器芯片
突发模式信号处理技术群	突发跨阻放大器信号及时序处理技术	自研	成熟应用	突发模式跨阻放大器芯片
	突发限幅放大器信号及时序处理技术	自研	成熟应用	突发模式限幅放大器芯片
	突发激光驱动器信号及时序处理技术	自研	成熟应用	突发模式激光驱动器芯片
	突发模式时钟数据恢复信号及时序处理技术	自研	样品	突发模式集成时钟数据恢复芯片
数模混合及智能控制处理技术群	智能诊断控制技术	自研	成熟应用	多合一光模块收发芯片
	高兼容性通信接口技术	自研	成熟应用	多合一光模块收发芯片
	微控制器集成技术	自研	成熟应用	微控制器芯片
高速率芯片测试技术群	高速高性能收发芯片验证技术	自研	成熟应用	全系列产品
	高可靠性、高效率量产测试技术	自研	成熟应用	全系列产品
光传感线性低噪模拟收发芯片设计技术群	大驱动能力、低噪声驱动设计技术	自研	样品	低噪声光传感用激光器驱动器
	高线性度、高增益、大摆幅输出跨阻放大器设计技术	自研	样品	高增益光传感用跨阻放大器
SOC 关键 IP 及 ASIC 集成技术群	高采样率/高分辨率 ADC/DAC 设计技术	自研	样品	SOC 芯片
	关键数字信号处理算法	自研	开发	SOC 芯片
	SOC 的 ASIC 集成技术	自研	开发	SOC 芯片
硅光组件技术群	光电协同的电互联设计技术	自研	样品	硅光组件
	低损、高可靠光耦合技术	自研	样品	硅光组件

（四）发行人的研发水平

公司重视技术研究开发工作，研发团队稳定性高，且均具有丰富的集成电路产品开发与项目实施经验。截至 2025 年 6 月 30 日，公司研发人员 84 人，占员工总数比例达 54.90%，公司 33%以上的研发人员拥有研究生及以上学位，是公

公司产品创新的重要人才基础。

公司采取引进与培养相结合的人才策略，丰富人才梯队建设，不断完善针对创新人才的各项保障制度，旨在增强对创新人才的吸引力和保留度，支撑公司的持续创新。公司十分注重对研发人才的培养和提拔，建立了针对各级人才的培训机制，从专业和管理两个维度提升技术人才综合能力，为研发人员成长提供适宜的工作环境。通过出国培训或与高校合作，“引智借脑”精心培养人才。截至目前已培养了近百名覆盖集成电路设计领域各个研发岗位的专业技术人才，为公司及行业技术创新提供持续动力。

（五）主要财务数据及指标

单位：万元

项目	2025.06.30/ 2025 年 1-6 月	2024.12.31/ 2024 年度	2023.12.31/ 2023 年度	2022.12.31/ 2022 年度
资产总额	84,494.39	81,745.51	58,739.99	42,281.94
归属于母公司所有者权益	78,153.29	72,512.19	50,730.57	33,363.49
资产负债率（母公司）	7.15%	10.99%	13.64%	21.09%
资产负债率（合并）	7.50%	11.30%	13.64%	21.09%
营业收入	23,849.87	41,055.91	31,313.34	33,907.23
净利润	4,695.88	7,786.64	7,208.35	8,139.84
归属于母公司所有者的净利润	4,695.88	7,786.64	7,208.35	8,139.84
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	4,168.69	6,857.10	5,491.41	9,573.14
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（剔除股份支付影响）	5,113.90	8,432.46	5,491.41	9,573.14
基本每股收益（元）	0.78	1.86	不适用	不适用
稀释每股收益（元）	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率	6.23%	12.05%	17.50%	26.90%
经营活动产生的现金流量净额	9,047.10	391.30	5,791.31	3,294.57
现金分红	-	1,800.00	-	4,000.00
研发投入占营业收入的比例	15.81%	19.10%	21.09%	21.14%

注 1：2022 年、2023 年，公司为有限责任公司，无需列示每股收益；报告期内，公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益指标不适用

注 2：公司 2024 年分红 1,800.00 万元，实际发放时间为 2025 年

（六）发行人存在的主要风险

1、市场与行业风险

（1）国际贸易摩擦风险

随着全球主要经济体经济增速持续放缓，贸易保护主义及国际经贸摩擦风险仍将存在。集成电路是高度全球化的产业，从上游供应链来看，公司晶圆、EDA软件、测试设备等供应商主要为境外企业，在贸易摩擦的背景下，如果进口关税上升，将导致公司采购成本大幅增加。在极端情况下，贸易摩擦可能导致公司无法向境外企业采购，从而对公司的生产经营带来重大负面影响。从下游应用市场来看，公司直接客户及终端客户同样会受到贸易摩擦的影响，导致其需求降低，进而影响公司经营业绩。

（2）市场竞争风险

我国集成电路设计服务行业正快速发展，良好的前景吸引了诸多国内企业进入该领域，行业内厂商则在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展，市场竞争预计日益激烈。在此趋势下，若未来公司不能准确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据客户需求及时进行技术、服务和产品创新，则公司可能在全球市场竞争中丧失竞争优势，对公司的持续盈利能力造成不利影响。

（3）产业政策风险

集成电路行业是国民经济和社会发展的战略性新兴产业，国家出台了一系列鼓励政策以推动我国集成电路行业的发展，增强行业创新能力和国际竞争力。若未来国家相关产业政策支持力度减弱，将对公司发展产生一定影响。

2、技术风险

（1）产品研发及技术迭代风险

集成电路设计行业为技术密集型行业，随着市场竞争的加剧以及终端客户对产品个性化需求的不断提高，行业中新技术、新产品不断涌现。公司需要根据技术发展趋势和终端客户需求，不断升级更新现有产品并研发新技术和新产品，从而通过持续的研发投入和技术创新，保持技术先进性和产品竞争力。

如果公司未能准确把握行业技术发展趋势、募集资金投资项目及新产品规划

偏离下游需求，或者研发效果不及预期、产品未能及时实现技术迭代，导致未能形成符合市场需求的产品，则公司可能面临丧失技术优势的风险，进而对公司的盈利能力和持续发展造成不利影响。

（2）知识产权泄露与侵权风险

集成电路行业具有技术密集性特征，知识产权与核心技术是公司的核心竞争力之一。通过多年的研发和技术积累，公司形成了多项自主研发的核心技术，目前已掌握深亚微米 CMOS、锗硅 Bi-CMOS 双工艺技术能力，具备从单通道 155Mbps 到多通道 800Gbps 的全速率超高速光通信电芯片设计经验。

尽管公司已经建立了严格的保密制度，但未来如果因个别员工保管不善、工作疏漏、外界窃取等原因导致核心技术泄密，将会影响公司的技术优势。此外，公司若未来与第三方产生知识产权纠纷，或公司员工、合作伙伴由于对知识产权的理解出现偏差等因素导致侵犯第三方知识产权，将会对公司的业务发展和经营业绩产生不利影响。

（3）关键技术人才流失风险

在集成电路设计行业，关键技术人员是公司获得持续竞争优势的基础，也是公司持续进行技术创新和保持竞争优势的主要因素之一。随着集成电路设计行业的持续发展，对集成电路关键技术人才的竞争将不断加剧，未来，如果公司核心技术人员离职，可能对公司产品研发进度、公司研发能力产生不利影响。

3、经营管理风险

（1）供应链稳定性风险

公司采用 Fabless 模式经营，供应商主要为晶圆代工厂和封测厂。由于集成电路行业的特殊性，晶圆代工厂和封测厂属于重资产企业、市场集中度较高。报告期内，公司供应商集中度较高，向前五大供应商采购金额占同期采购金额的比例分别为 86.36%、83.68%、89.47%、84.48%，因此稳定的供应链对公司至关重要。

目前，公司与境内外晶圆代工厂均有深度合作，若未来由于国际政治经济形势、下游行业需求和国际半导体产业链格局等因素变动，导致晶圆及封测产能紧

张甚至断供、采购价格大幅上涨，可能导致公司产品不能按期交货或成本大幅上涨，从而对公司生产经营产生不利影响。

(2) 产品质量风险

芯片产品的质量是公司保持竞争力的基础。由于芯片产品的高度复杂性，公司无法完全避免产品质量的缺陷。若公司产品质量出现缺陷或未能满足客户对质量的要求，公司可能需承担相应的赔偿责任并可能对公司经营业绩、财务状况造成不利影响；同时，公司的产品质量问题亦可能对公司的品牌形象、客户关系等造成负面影响，不利于公司业务经营与发展。

(3) 经营规模较小的风险

报告期内，公司实现的营业收入分别为 33,907.23 万元、31,313.34 万元、41,055.91 万元、23,849.87 万元，经营规模与国际厂商相比仍存在较大差距，存在经营规模较小，抗风险能力较弱的风险。Macom、Semtech 等境外龙头企业产品线覆盖光通信电芯片、射频芯片、模组及多个领域，业务结构多元，有助于抵御行业波动风险。与国际厂商相比，公司业务聚焦于光通信电芯片领域，虽然公司产品应用涵盖接入网、4G/5G/5G-A 无线网络、数据中心、城域网和骨干网等多领域，但是产品结构相对单一。未来若国内外的宏观经济形势、行业政策、下游市场需求或公司自身经营管理、技术研发等因素出现重大不利变化，或发生不可抗力导致的风险，将会对公司的整体经营造成不利影响。

4、财务风险

(1) 经营业绩波动或下滑的风险

报告期内，公司实现的营业收入分别为 33,907.23 万元、31,313.34 万元、41,055.91 万元、23,849.87 万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为 9,573.14 万元、5,491.41 万元、6,857.10 万元、4,168.69 万元，公司主营业务的毛利率分别为 55.26%、49.14%、46.75%、43.48%，毛利率呈现下降趋势。

当前，公司产品结构以 10Gbps 及以下产品为主，25Gbps 及以上速率产品仍处于逐步渗透及拓展阶段。随着行业技术的发展和市场竞争的加剧，公司必须根据市场需求不断进行技术的迭代升级和创新。如果公司未能正确判断下游需求变化，或公司技术实力停滞不前，或公司产品市场竞争格局发生变化，可能导致公

公司产品销量降低、售价下降，从而造成毛利率、经营业绩下滑。

(2) 存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 12,978.43 万元、9,035.85 万元、17,496.63 万元、14,294.14 万元，占流动资产的比例分别为 38.48%、25.45%、32.55%、25.65%。如果主要产品的价格出现大幅下滑或者销售不畅，而公司未能及时有效应对并做出相应调整，将可能使得存货可变现净值低于成本，对公司的经营业绩产生不利影响。

(3) 汇率波动风险

报告期内，公司境外采购、销售采用美元结算。报告期内，公司汇兑净损失分别为-129.53 万元、119.68 万元、210.39 万元、57.47 万元。如果未来受国内外政治、经济等因素影响，美元兑人民币的汇率大幅波动，将可能导致公司产生较大的汇兑损失，从而引起公司利润水平的波动，对公司未来的经营业绩稳定造成不利影响。

(4) 税收优惠政策风险

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)，公司自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

公司于 2020 年 10 月通过高新技术企业认定，编号为“GR202035100307”，有效期三年，并于 2023 年 12 月再次通过高新技术企业认定，编号为“GR202335101015”，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，减按 15%税率缴纳企业所得税。同时，根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8 号)及其配套政策等规定，企业所得税按 10%的税率计算。

若未来上述税收优惠政策发生调整，或者公司不再满足享受以上税收优惠政策的条件，则将对公司的经营业绩产生一定影响。

5、内部控制风险

(1) 实际控制人控制风险

本次发行前，实际控制人柯炳舜与柯腾隆合计控制公司 27.13%表决权，其中柯炳舜直接持有公司 10.92%股份，同时通过担任科迅发展的执行事务合伙人间接控制公司 4.59%表决权；柯腾隆担任员工持股平台芯优迅、芯聚才、优迅管理的执行事务合伙人，并通过前述三个员工持股平台控制公司 11.63%表决权。本次发行后（不含超额配售选择权），实际控制人控制的表决权比例稀释至 20.35%，可能出现公司控制权被第三方收购或其他影响其履行公司决策权和控制权的不利情形，存在一定的控制权变更风险，从而对公司的业务发展、经营业绩及人员管理稳定产生不利影响。

(2) 业务规模扩张导致的管理风险

随着公司业务的发展及募集资金投资项目的实施，公司收入规模和资产规模将会持续扩张，相应将在资源整合、市场开拓、内部控制等方面对管理人员提出更高的要求。如果公司内控体系和管理水平不能适应公司规模快速扩张，公司可能发生规模扩张导致的经营管理和内部控制风险。

6、募集资金投向风险

(1) 募集资金投资项目实施风险

本次募集资金投资项目可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、公司研发能力和技术水平、未来市场拓展情况等因素做出。公司对募集资金投资项目的技术、市场、管理等方面进行了慎重、充分的调研和论证，在决策过程中综合考虑了各方面情况，并在技术、资质、人才等方面做了充分准备。

公司认为募集资金投资项目有利于加快产品研发进度，推进公司新产品的产业化落地。但项目在实施过程中将受到宏观政策、市场环境变化、产品市场销售状况、研发进展等因素的影响，实际实施情况与公司预测情况可能存在差异。如果投资项目不能顺利实施，或实施后由于市场开拓不力投资收益无法达到预期，公司可能面临投资项目失败的风险。

（2）本次发行摊薄即期回报的风险

本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加。但由于募集资金使用产生效益需要一定周期，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，预计短期内公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后股东即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险，特提请投资者注意投资风险。

7、其他风险

（1）发行失败风险

根据相关法规要求，若本次发行时有效报价投资者或网下申购的投资者数量不足法律规定要求，或者发行时总市值未能达到上市条件的预计市值，本次发行应当中止。若公司中止发行上市审核程序超过上交所规定的时限或者中止发行注册程序超过3个月仍未恢复，或者存在其他影响发行的不利情形，将会出现发行失败的风险。

（2）未来股票价格波动风险

股票的价格不仅受到公司财务状况、经营业绩和发展潜力等内在因素的影响，还会受到宏观经济形势、投资者情绪、资本市场资金供求关系、区域性或全球性的经济危机、国内外经济社会动荡等多种外部因素的影响。投资者应充分了解股票市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

二、申请上市股票的发行情况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币1.00元
发行规模	不超过2,000.00万股（不含采用超额配售选择权发行的股份数量）
每股发行价格	人民币【】元
发行方式	本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，或中国证监会认可的其他方式
发行对象	符合资格的战略投资者、网下投资者和上交所开户的境内自然人、法人等投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象

承销方式	余额包销
拟上市地点	上海证券交易所科创板

三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

中信证券指定戴五七、马锐为优迅股份首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人；指定刘博瑶为项目协办人；指定吴小琛、曾文煜、刘翹楚、黄靖义、卢芳菲、刘付鹏、郑邦威、马环宇、陈靖、许艺彬为项目组成员。

（一）项目保荐代表人保荐业务主要执业情况

戴五七，中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人，注册会计师。曾负责或参与了绿康生化、东亚机械、八马茶业等首次公开发行项目；金龙汽车非公开发行、罗平锌电非公开发行、英联股份非公开发行等再融资项目；罗平锌电、中利集团等重组收购项目。

马锐，中信证券投资银行管理委员会总监，保荐代表人，注册会计师。曾负责或参与了弘信电子、绿康生化、东亚机械、兴通股份等首次公开发行项目；厦工股份非公开及公开增发项目、金龙汽车配股及非公开发行项目、罗平锌电非公开发行、兴通股份向特定对象发行等再融资项目；罗平锌电、兴通股份、建发股份等重大资产重组项目。

（二）项目协办人保荐业务主要执业情况

项目协办人：刘博瑶，中信证券投资银行管理委员会副总裁。曾参与东亚机械、兴通股份等首次公开发行项目；金龙汽车非公开发行、兴通股份向特定对象发行等再融资项目；建发股份、兴通股份重大资产重组项目。

（三）项目组其他成员

项目组其他成员包括：吴小琛、曾文煜、刘翹楚、黄靖义、卢芳菲、刘付鹏、郑邦威、马环宇、陈靖、许艺彬。

（四）本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员自愿接受上海证券交易所自律监管的承诺

本次证券发行上市的保荐代表人戴五七和马锐、协办人刘博瑶及项目组其他成员自愿接受上海证券交易所自律监管的承诺如下：

“本人将遵守法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所对推荐证券上市的规定，自愿接受上海证券交易所的自律监管措施。”

四、保荐人是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形说明

（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

发行人无控股股东，实际控制人为柯炳森、柯腾隆。

截至本上市保荐书签署日，本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行人或其重要关联方股份。

此外，本保荐人将按照上交所相关规定，安排依法设立的相关子公司参与本次发行战略配售，并按照股票发行价格认购发行人首次公开发行股票数量 2%至 5%的股票，具体比例根据发行人首次公开发行股票规模分档确定。保荐人及相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件。

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份情况

发行人无控股股东，实际控制人为柯炳森、柯腾隆。

除可能存在少量、正常的二级市场证券投资外，截至本上市保荐书签署日，发行人或其实际控制人、重要关联方未持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份。

（三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况

截至本上市保荐书签署日，本保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在持有发行人权益及在发行人处任职等情况。

（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况

发行人无控股股东，实际控制人为柯炳森、柯腾隆。

截至本上市保荐书签署日，除中信银行股份有限公司为发行人提供常规的银行业务服务外，本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。

（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系

截至本上市保荐书签署日，本保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

五、保荐人承诺事项

（一）本保荐人已按照法律法规和中国证监会及上交所的相关规定，对发行人及其发起人、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

保荐人同意推荐厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行股票并在上交所科创板上市，相关结论具备相应的保荐工作底稿支持。

（二）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第二十六条的规定，中信证券作出如下承诺：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、上交所有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证本上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、

中国证监会、上交所的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。

六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序

（一）董事会决策程序

2024 年 8 月 1 日，发行人召开了第一届董事会第四次会议，全体董事出席会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》等相关议案。

根据 2024 年第四次临时股东大会的授权，并经 2025 年 9 月 5 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，公司决定取消募集资金投资项目中的“补充流动资金”项目（该项目原投资总额为 8,000 万元），并相应调整募集资金总额。

（二）股东大会决策程序

2024 年 8 月 16 日，发行人召开了 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》等相关议案。

综上，保荐人认为，发行人本次发行已获得了必要的批准和授权，履行了必要的决策程序，决策程序合法有效。

（三）保荐人核查意见

经核查，本保荐人认为：上述董事会、股东大会的召集和召开程序、召开方式、出席会议人员的资格、表决程序和表决内容符合《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》及发行人《公司章程》的相关规定，表决结果均合法、有效。发行人本次发行已经依其进行阶段，取得了法律、法规和规范性文件所要求的发行人内部批准和授权，授权程序合法、内容明确具体，合法有效。

七、保荐人关于发行人符合科创板定位要求的核查意见

（一）发行人符合行业领域要求

公司 所属 行业	<input checked="" type="checkbox"/> 新一代信息 技术	公司主要从事光通信前端收发芯片的研发、设计与销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”（代码：
	<input type="checkbox"/> 高端装备	

领域	<input type="checkbox"/> 新材料	6520），细分行业为芯片设计行业。根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016 版）和国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“新一代信息技术产业”。根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，公司所属的集成电路设计行业属于鼓励类产业。因此，根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第四条的规定，发行人所属行业领域为新一代信息技术领域，属于科创板支持和鼓励的高新技术产业和战略新兴产业，符合科创板行业定位
	<input type="checkbox"/> 新能源	
	<input type="checkbox"/> 节能环保	
	<input type="checkbox"/> 生物医药	
	<input type="checkbox"/> 符合科创板定位的其他领域	

（二）发行人符合科创属性要求

科创属性相关指标一	是否符合	指标情况
最近三年研发投入占营业收入比例 5%以上，或最近三年研发投入金额累计在 8,000 万元以上	符合	2022 年-2024 年累计研发投入 21,615.63 万元，占营业收入比例为 20.34%
研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%	符合	截至 2024 年 12 月 31 日，公司研发人员为 81 人，占同期员工总数比例为 57.04%
应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利 7 项以上	符合	截至 2025 年 6 月 30 日，应用于公司主营业务的发明专利为 83 项
最近三年营业收入复合增长率达到 25%，或最近一年营业收入金额达到 3 亿元	符合	2024 年度，公司营业收入 41,055.91 万元

（三）保荐人核查意见

保荐人查阅了相关行业报告和市场研究资料，了解了近年来行业相关政策，对发行人所在行业的市场情况和竞争格局进行了分析；对发行人高级管理人员及核心技术人员进行了访谈，查阅了核心技术人员的简历，实地查看发行人的研发场所和研发设备，查阅发行人研发管理相关制度等文件，了解发行人主要产品的应用领域发挥作用；查阅发行人已取得的专利证书，查阅发行人的研发成果及所获荣誉证明；实地查看发行人的经营场所，核查发行人实际经营情况，对发行人的主要供应商、客户进行了函证及走访，抽查了发行人的采购合同、销售合同，对主要客户销售流程及主要供应商采购流程进行了穿行测试。

经核查，保荐人认为，发行人属于重点推荐的符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业，符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》的要求。公司发展面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，符合《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》和《首次公开发行股票注册管理办法》等文件、法规中对于科创板企业的定位要求。

八、保荐人对发行人是否符合科创板上市条件的说明

优迅股份股票上市符合《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件：

- （一）本次发行后优迅股份股本总额将不低于人民币 3,000 万元。
- （二）本次公开发行后，优迅股份累计已公开发行的股份占优迅股份本次发行后股份总数的比例不低于 25%。
- （三）依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，发行人选择具体上市标准如下：“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

根据容诚会计师出具的《审计报告》（容诚审字[2025]361Z0008 号），发行人 2024 年度经审计的营业收入为 41,055.91 万元，高于 1 亿元，2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司所有者的净利润为 6,857.10 万元，最近一年净利润为正。结合公司历史融资情况及可比公司在境内市场的近期估值情况，基于对发行人市值的预先评估，预计发行人发行后总市值不低于人民币 10 亿元。

综上所述，优迅股份满足其所选择的上市标准。

- （四）优迅股份最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载。
- （五）上海证券交易所要求的其他条件。

九、保荐人对发行人持续督导工作的安排

事项	工作安排
（一）持续督导事项	在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后三个完整会计年度内对发行人进行持续督导
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、实际控制人、其他关联机构违规占用发行人资源的制度	强化发行人严格执行中国证监会相关规定的意识，进一步完善各项管理制度和发行人的决策机制，协助发行人执行相关制度；通过《保荐协议》约定确保保荐人对发行人关联交易事项的知情权，与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	督导发行人有效执行并进一步完善内部控制制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性	督导发行人尽可能避免和减少关联交易，若有关的关联交易为发行人日常经营所必须或者无法避免，督导发行人按照《公司章

事项	工作安排
和合规性的制度，并对关联交易发表意见	程》、《关联交易管理制度》等规定执行，对重大的关联交易本机构将按照公平、独立的原则发表意见
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	与发行人建立经常性信息沟通机制，督促发行人负责信息披露的人员学习有关信息披露的规定
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	督导发行人按照《募集资金使用管理办法》管理和使用募集资金；定期跟踪了解项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东大会，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	督导发行人遵守《公司章程》、《对外担保管理制度》以及中国证监会关于对外担保行为的相关规定
7、持续关注发行人经营环境和业务状况、股权变动和管理状况、市场营销、核心技术以及财务状况	与发行人建立经常性信息沟通机制，及时获取发行人的相关信息
8、根据监管规定，在必要时对发行人进行现场检查	定期或者不定期对发行人进行回访，查阅所需的相关材料并进行实地专项检查
（二）保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	有权要求发行人按照证券发行上市保荐有关规定和保荐协议约定的方式，及时通报与保荐工作相关的信息；在持续督导期间内，保荐人有充分理由确信发行人可能存在违法违规行以及其他不当行为的，督促发行人做出说明并限期纠正，情节严重的，向中国证监会、上海证券交易所报告；按照中国证监会、上海证券交易所信息披露规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明
（三）发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐职责的相关约定	发行人及其高管人员以及为发行人本次发行与上市提供专业服务的各中介机构及其签名人员将全力支持、配合保荐人履行保荐工作，为保荐人的保荐工作提供必要的条件和便利，亦依照法律及其它监管规则的规定，承担相应的责任；保荐人对发行人聘请的与本次发行与上市相关的中介机构及其签名人员所出具的专业意见存有疑义时，可以与该中介机构进行协商，并可要求其做出解释或者出具依据
（四）其他安排	无

十、保荐人认为应当说明的其他事项

无其他应当说明的事项。

十一、保荐人对本次股票上市的推荐结论

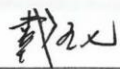
保荐人中信证券股份有限公司认为，发行人厦门优迅芯片股份有限公司申请其股票上市符合《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定，发行人股票具备在上交所科创板上市的条件，同意推荐发行人在上交所科创板上市。

鉴于上述内容，保荐人中信证券股份有限公司推荐发行人厦门优迅芯片股份

有限公司的股票在贵所上市交易，请予批准！

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签字盖章页）

保荐代表人：

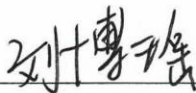


戴五七



马 锐

项目协办人：

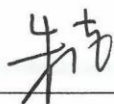


刘博瑶



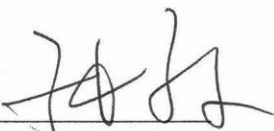
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签字盖章页）

内核负责人：



朱 洁

保荐业务负责人：



孙 毅



（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签字盖章页）

总经理：


邹迎光



（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签字盖章页）

董事长、法定代表人：

张佑君

中信证券股份有限公司

